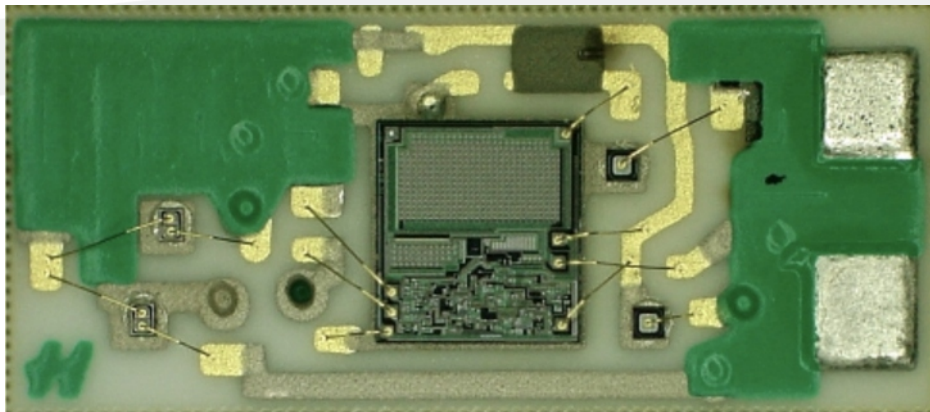


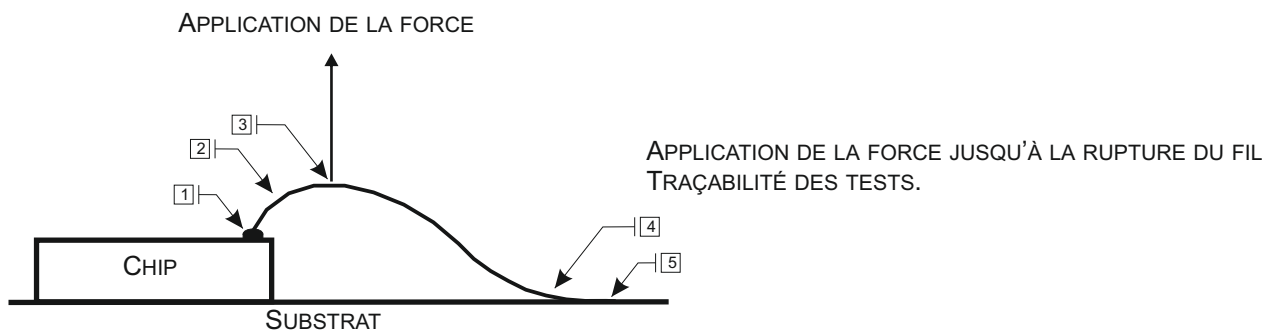
HYBRID SA EST À MÊME DE CÂBLER LES CHIPS NUS. LES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES DU PERSONNEL AINSI QU'UN PARC DE MACHINES MODERNE PERMET L'EXÉCUTION DE PLAN DE BONDING COMPLEXE ET DE HAUTE DENSITÉ. (CHIP TO CHIP, CHIP ON CHIP, ETC...)

WIRE BONDING OR (BALL BONDING)

DIAMÈTRE : STANDARD 20 μ m - 30 μ m



TEST D'ARRACHAGE



WIRE BONDING ALUMINIUM (WEDGE BONDING)

DIAMÈTRE : STANDARD 25 μ m - 33 μ m

